

Fill-Gel 600导热凝胶

产品描述



Fill-Gel600是一款单组份、无需后固化的硅系导热凝胶，是用于填充大缝隙公差场合的理想材料。此款导热凝胶具有高触变性及可塑性，在较低压力下可以均匀填充到不同厚度的空隙里，适用于多个发热器件共用同一个散热器场景，或应用在需要较低机械应力的电子组件中，保护敏感电子元器件不受损伤。

Fill-Gel600导热凝胶具有极高的导热性能，导热系数为6.0W/m-K，特殊的配方设计使其具有低挥发特点和抗开裂、抗垂流特性，尤其适用于通信行业应用。超软及自粘性在装配过程中易于返工，降低施工难度。

产品特点

- ◆ 6.0W/m-K导热率
- ◆ 单组份材料，无后固化，适合自动化操作
- ◆ 高可靠性及热稳定性
- ◆ 低渗油特性、无pump-out
- ◆ 柔软，低装配压力和低残余应力
- ◆ 抗开裂、抗垂流特性

典型应用

- ◆ 机箱或者相关散热模块
- ◆ 需要低装配压力的发热装置
- ◆ 智能终端，手机，平板电脑
- ◆ 通信基站硬件散热
- ◆ 大型存储数据中心
- ◆ 内存模块

技术参数

性能参数	Fill-Gel 600	测试方法
基本特性		
结构	陶瓷粉填充单组份硅凝胶	N/A
后固化反应	无	N/A
颜色	灰色	目视
密度 (g/cm ³)	3.5	ASTM D792
挤出速率 (g/min)	20	泰吉诺实验室(30cc EFD管, 2.5mm管口直径, 90psi & 60s)
ΣD3-D10 (硅氧烷含量PPM)	<200	GC-MS
工作温度(°C)	-40 ~ 150	泰吉诺实验室
最小界面厚度 (mm)	0.2	泰吉诺实验室
导热性能		
导热系数 (W/m-K)	6.0	ASTM D5470
电学性能		
体积电阻率(ohm-cm)	$\geq 1.0 \times 10^{13}$	ASTM D257
介电强度 (KV/mm)	≥ 6	ASTM D149
阻燃等级		
阻燃等级	V-0	UL 94

注：本资料中数据皆为测试典型值，结果仅供参考，不可作为产品性能指标使用

注意事项

- ◆ 切勿食用
- ◆ 避开儿童可触及的地方保管
- ◆ 产品放置须远离火源
- ◆ 请确认使用的正确性之后再使用

保存及寿命

- ◆ 产品需在0-35°C，不超过65%相对湿度环境下密封保存
- ◆ 保质期自包装之日起12个月

订购信息

- ◆ 可提供30cc, 300 cc, 和600 cc针管包装，及5加仑桶装

